



8. Symposium Connectors

Elektrische und
optische
Verbindungstechnik

Vorträge: 23. - 24. März 2021
Tutorial am 22. März 2021

Tagung / Tutorial

Die VDE/VDI Gesellschaft Mikroelektronik, Mikrosystem- und Feinwerktechnik (GMM) in Zusammenarbeit mit der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe und dem VDI Ostwestfalen-Lippe Bezirksverein e.V. lädt Sie herzlich zur Teilnahme am **8. Symposium Connectors vom 23. bis 24. März 2021** ein. Coronabedingt findet diese Veranstaltung erstmalig als **Onlinekongress** statt. Wir geben Ihnen auch in der virtuellen Konferenzform viel Gelegenheit, Wissen und Ideen zu sammeln, Kontakte zu knüpfen und sich über Erfahrungen und Erkenntnisse auszutauschen. Eine digitale Plattform für Aussteller ist geplant. Weitere Informationen zur Anmeldung, Ausstellung und Begegnungsmöglichkeiten erhalten Sie in Kürze auf www.connectors-symposium.com

Am Vortag (22. März 2021) findet ein **Tutorial** zu dem Thema „Normung“ mit dem Vortragenden **Wolfgang Niedziella** (Geschäftsführer in der VDE Gruppe, Präsident Elect der europäischen Normungsorganisation CENELEC) statt.

Inhalte:

- Was ist Normung?
- Normungsgrundsätze
- Regeln der Normungsarbeit
- Erarbeitung einer DIN-Norm
- Erarbeitung einer Europäischen Norm (EN)
- Erarbeiten einer Internationalen Norm (IEC)
- Koordination der Normungsorganisationen
- CE-Kennzeichnung

Eine gesonderte Anmeldung ist erforderlich.

Die Fachtagung Symposium Connectors, die alle zwei Jahre stattfindet, bietet eine Plattform für die Industrie, Institutionen und Hochschulen, auf der die neuesten und wichtigsten Entwicklungen und Erfahrungen im Bereich der elektrischen und optischen Steckverbindungen sowie deren Applikationen mittels hochwertigen wissenschaftlichen Beiträgen erörtert werden.

Ausstellung

Sie möchten als Aussteller aktiv werden? Sie bekommen einen eigenen Showroom, die Ausstellergebühr beträgt 250 €.

Teilnahmegebühr

Ein/erster Teilnehmer je Unternehmen (Vollzahler):	230 € ¹
Frühbücher, bei Anmeldung bis zum 19.02.2021:	180 € ¹
Jeder weitere Teilnehmer eines Unternehmens:	170 € ^{1,2}
Frühbücher, bei Anmeldung bis zum 19.02.2021:	120 € ^{1,2}
Tutorial (nur gesondert buchbar)	15 €
Aussteller	250 €

1) Die Teilnahmegebühren verstehen sich inklusive digitalen Tagungsband (PDF-Datei), zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. Es gelten unsere Teilnahmebedingungen. Eine Druckversion des Tagungsbandes kann gegen Aufpreis von 10 € separat erworben werden.

2) Ein Vollzahler eines Unternehmens erforderlich.

Die Erstattung der Tagungsgebühr im Fall der Absage des Teilnehmenden ist nur bis zum 05.03.2021 möglich.

Anmeldung (per E-Mail an: con.sym@th-owl.de)

Name _____

Vorname _____

Titel _____

Institution _____

E-Mail _____

Rechnungs-Adresse _____

Teilnehmer Aussteller

Ja, ich möchte am Tutorial am 22.03.2021 teilnehmen (15 € Teilnahmegebühr).

Ja, ich möchte das Tagungsband als Druckversion (Aufpreis siehe oben).

Ich stimme der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten durch die TH OWL zur Planung und Durchführung des Symposium Connectors 2021 zu. Die Daten werden nach Beendigung der Durchführung des Symposiums gelöscht.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Tagungsbüro unter
con.sym@th-owl.de

Programm Symposium Connectors 2021**Tutorial 22.03.2021****Normung**

- Normungsgrundsätze
- Regeln der Normungsarbeit
- Erarbeitung einer DIN-Norm
- Erarbeitung einer Europäischen Norm (EN)
- Erarbeiten einer Internationalen Norm (IEC)
- Koordination der Normungsorganisationen
- CE-Kennzeichnung

Wolfgang Niedziella

(Geschäftsführer in der VDE Gruppe, Präsident Elect der europäischen Normungsorganisation CENELEC)

23. bis 24. März 2021

Hochbeständige, physikalisch abgeschiedene Kontaktobерfläche auf Silberbasis für die Anwendung in Buchsenkontakten

Felix Greiner¹, Sönke Sachs¹, Helge Schmidt¹, Marjorie Myers², Michael Leidner¹, Waldemar Stabroth¹, Frank Ostendorf¹, TE Connectivity, ¹Bensheim, ²Harrisburg, USA

Elektrische und tribologische Eigenschaften von Silber-Dispersionsschichten für die Anwendung in Steckverbindungen

Marcella Oberst¹⁾, Toni Israel¹⁾, Stephan Schlegel¹⁾, Ann-Kathrin Egetenmeyer²⁾, Heidi Willing²⁾

*1) Technische Universität Dresden
2) Forschungsinstitut Edelmetalle und Metallchemie, Schwäbisch Gmünd*

Optimierte Zinnbeschichtung für erhöhte Anwendungstemperaturen

*Benjamin Cappi
Aurubis Stolberg, Stolberg*

Ausstellung und Pause

Keynote

Aktuelle Herausforderungen der Elektromobilität

Ralf Petri, VDE

Ausstellung und Pause

DLIP Laserstrukturierung von Steckverbindern zur Reduzierung von Steckkräften oder dem elektrischen Kontaktwiderstand
*Leander Reinert¹, Dominik Britz, Nikolaus Wanke, Andrés Lasagni, Frank Mücklich
1) SurFunction, Saarbrücken*

Untersuchung von Steckverbindungen bei Strombelastung im Milli- bis Mikrosekunden-Bereich
*Toni Israel, Ragnar Müller, Stephan Schlegel
Technische Universität Dresden,
Institut für Elektrische Energieversorgung und Hochspannungstechnik
Helge Schmidt, Michael Ludwig
TE Connectivity, Bensheim*

Untersuchung der Korrelation zwischen Verschleißenergie und Verschleißvolumen an Steckverbindern mit Silberbeschichtung

*Dirk Hilmert, Haomiao Yuan, Jian Song
Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe, Lemgo*

Ausstellung und Pause

Analyse von automobiltauglichen Crimpverbindungen mittels FEM-Simulation

*Christian Trebehs
KOSTAL Kontakt Systeme, Lüdenscheid*

Optimierung von Steckkontakteen mittels gekoppelter Simulation und entsprechender experimenteller Validierung

*Tobias Langer¹, Sascha Nolte¹, Abhay Shukla², Haomiao Yuan², Roman Probst², Jian Song²
1) Weidmüller, Detmold
2) Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe, Lemgo*

Analytical Model for Ultrasonic Metal Welding Process as Virtual Data Source for Machine Learning

*Elisabeth Birgit Schwarz¹, Fabian Bleier¹, Jean-Pierre Bergmann²
1) Corporate Sector Research and Advance Engineering, Robert Bosch, Renningen.
2) Faculty of Mechanical Engineering, Technische Universität Ilmenau.*

Theorie, Grenzen und Anwendungen der thermischen Ersatzschaltbilder für Steckverbinder
*Michael Ludwig, Michael Leidner, Helge Schmidt, Frank Ostendorf
TE Connectivity, Bensheim*

ODT-Quantifizierung mittels EDX auf einzelnen Steckern
*Martin Bühner
nanoAnalytics, Münster*

Oberflächenanalytische Untersuchungen an elektrischen Steckkontakteen

*Philipp Kolmer¹, Jian Song², Dieter Schramm³
Volkswagen, Group Innovation¹
Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe,
Labor für Feinsystemtechnik²
Universität Duisburg-Essen,
Lehrstuhl für Mechatronik³*

Fretting behavior of tin plated electrical contacts under various lubrications

*Haomiao Yuan, Jian Song
Precision Engineering Laboratory,
Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe, Lemgo
Ausstellung und Pause*

Beurteilung von Leiterplatten für Datensteckverbinder durch Messung der Resonanzfrequenzen des Wechselstromwiderstandes

*Johannes Werning, Thomas Kaps
Phoenix Contact, Blomberg*

Schwingungsarten der Vibrationsprüfung und deren Einfluss auf die Ausfallrate von Steckverbindern

*Kevin Krüger, Jian Song
Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe, Lemgo*

Untersuchung lokaler Kontaktwiderstände durch Rastersonden-Mikro-Abtastung von Kontaktobерflächen

*Sönke Sachs, Helge Schmidt,
TE Connectivity, Bensheim*